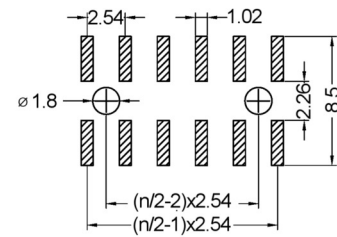
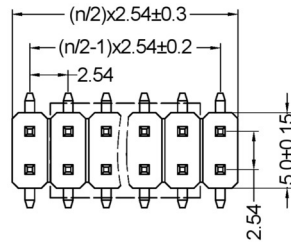
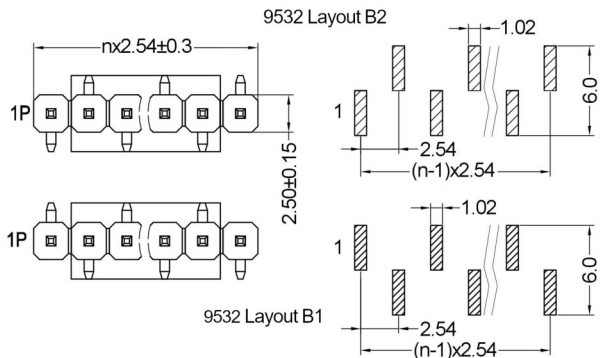


# 46-9532 / 46-9132 Economy Version

SMT-Stiftleisten RM 2,54mm, stehend – geprägte Kontakte  
SMT Pin Headers, 2.54mm Pitch, Vertical – Stamped & Formed Contacts

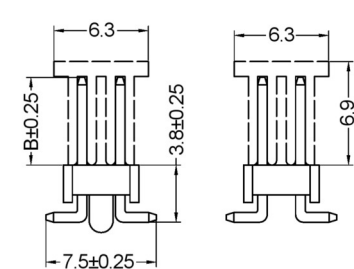
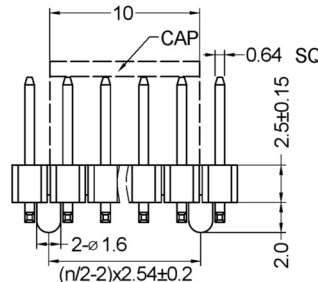
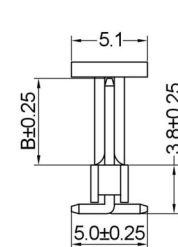
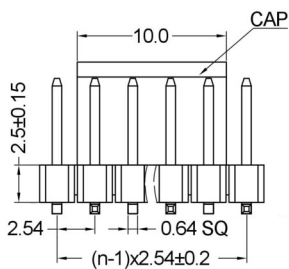
## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung <i>0.64mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Au over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	1000 MΩ min. <i>1000 MΩ min.</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000 V AC/DC <i>1000 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden, einreihig) (260 °C für 5 Sekunden, zweireihig) <i>230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds, single row) (260 °C for 5 seconds, double row)</i>
Processing	



Recommended P.C.B Layout (Top Side)  
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)

Recommended P.C.B Layout (Top Side)  
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating	Layout*	Loc. Pegs*	Packaging*
<b>46-9532</b>	<b>13</b>	<b>020</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>00</b>	<b>ST</b>
46-9532 Einreihig <i>Single row</i>	12 B=3,50mm 13 B=4,80mm	003-040 Einreihig <i>Single row</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i>	0 (Für Serie 46-9132) <i>(For series 46-9132)</i>	00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i>	ST
46-9132 Zweireihig <i>Double row</i>	14 B=6,10mm 15 B=6,90mm 16 B=9,90mm 17 B=5,84mm 18 B=8,13mm 99- Kunden-spezifisch <i>Customer-specific</i>	004-080 Zweireihig <i>Double row</i>		1 Layout B1 (46-9532) 2 Layout B2 (46-9532)	10 Mit Pos.hilfen <i>(46-9132) With loc. pegs (46-9132)</i>	PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*  
PPST In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*  
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

\* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an order example - please replace by your specifications.

# Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb $T_L$	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	Lower Temperature [°C]
Duration above $T_L$	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

